



Ingénierie des cryomodules

Ecole des Accélérateurs – BENODET - 2016

Patricia Duchesne IPNO – Division Accélérateurs Institut de Physique Nucléaire d'Orsay





□ INTRODUCTION

□ FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

□ ASPECTS THERMIQUES

□ ASPECTS MECANIQUES

□ ASPECTS MAGNETIQUES

□ DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





□ INTRODUCTION

□ FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE



DESIGN D'UN CRYOMODULE





INTRODUCTION



DESIGN D'UN CRYOMODULE



Un cryomodule est une maille élémentaire d'un accélérateur contenant des cavités Supraconductrices Radio Fréquence (SRF) et des composants nécessaires à leur fonctionnement à très basse température (cryogénique).







Un cryomodule, c'est : Une partie d'une section accélératrice Une partie d'un système cryogénique Sous-systèmes indépendants ou connectés Type et nombre de cavités et d'éléments de focalisation : les uns aux autres : Le système cryogénique global impacte sur Le design de l'accélérateur détermine en la segmentation de l'accélérateur et donc partie la composition du cryomodule sur le cryomodule

Le design d'un cryomodule dépend de plusieurs paramètres :

- > Le design de l'accélérateur (composants d'accélération et de guidage, séquence)
- > Le système cryogénique global (sous-systèmes indépendants ou non)
- > Les performances attendues de l'accélérateur (fiabilité, disponibilité ...)

Le coût

Coût de fabrication : 7 facteur de remplissage (cryomodules longs, interconnexions courtes) Coût de fonctionnement : > Pertes statiques (cryomodules longs connectés cryogéniquement)



CRYOMODULES/CRYOSTATS, QUELQUES EXEMPLES









□ FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





Un environnement cryogénique pour la masse froide

Distribution (lignes, séparateur de phases, vannes) du fluide cryo (liquide ou gaz) aux températures souhaitées

• Les tanks des cavités/aimants sont remplis d'hélium liquide à 4K ou moins

- o L'écran thermique peut être activement refroidi avec de l'hélium gaz
- o L'écran magnétique
- o Le coupleur de puissance

□ Isolation thermique (écrans, vide et super-isolation) contre toute source de transfert de chaleur de la température ambiante vers la température cryogénique

- $\circ \text{ Conduction}$
- \circ Convection
- o Rayonnement

Supportage et positionnement des composants

o Support structurel de la masse froide

 Alignement précis des cavités par rapport à l'axe faisceau et garantie de leur bon positionnement en fonctionnement (après cycles thermiques)

□ Interface entre la masse froide et la température ambiante

 Points de connexion pour les systèmes à intégrer : courant, RF, instrumentation et cryogénie

Protection magnétique contre le champ magnétique terrestre et toute autre source





G FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE











Train de cavités supraconductrices RF (équipées de leur tank hélium et de leurs équipements) avec présence éventuelle d'aimants supraconducteurs de focalisation

SC cavité: Niobium, Tank hélium : titane, acier inox

- Cavité: résonateur elliptique, spoke, quart d'onde ou demi-onde.
- Assemblage du train : ultra propreté nécessaire sur les parois internes de la cavité et du coupleur
 Le train est préparé en salle blanche classe 10 avec montage des coupleurs de puissance, des transitions chaud/froid et des vannes à vide aux extrémités.







Fournir une protection contre le champ magnétique terrestre et autres champs d'autres sources (ex: Champs de fuite des aimants)

AMUMETAL (alliage nickel-fer) à température ambiante, CRYOPERM à basse température

Autour de la cavité (écran à basse température)

Pour être efficace, l'écran peut être refroidi avant que la cavité n'atteigne sa température critique (supraconductivité)

Autour de tous les composants de l'enceinte à vide (écran à température ambiante)

Ecran magnétique avec système de refroidissement entre deux parois (Cryoperm):

Ecran magnétique (Cryoperm) autour de chaque each cavity:

Cavité elliptique SPL

Cavité double Spoke ESS

COMPOSANTS PRINCIPAUX





Circuits de distribution de fluides cryogéniques à différentes temperatures

Acier inox, aluminium ou cuivre

Son design dépend de la distribution cryogénique globale de l'accélérateur (voir § Schéma cryogénique d'un cryomodule):

Cryomodules connectés pour former un train cryo (minimiser le nombre d'alimentations cryogéniques) →
 Tubes de refroidissement et de retour intégrés à l'intérieur du cryomodule

- Cryomodules cryogéniquement Indépendants → Chaque cryomodule est connecté à la ligne de transfert cryogénique (CTL) via une boîte à vannes.





ECRANS THERMIQUES



Ecran thermique actif à température intermédiaire (50-80K) Ecran thermique passif (Isolation multicouche)

- → Pour minimiser les transferts thermiques par rayonnement
- Ecran métallique : aluminium ou cuivre refroidi activement à 50K-80K
 Son design est fortement conditionné par les contraintes liées aux contractions thermiques et celles d'assemblage
- MLI (Multi Layer Insulation): composée de couches réfléchissantes (aluminium) alternées d'isolants (mylar) placée sur :
 - la surface de l'écran thermique (~ 30 couches)
 - la surface des composants à plus basses températures (~ 10 couches)





COMPOSANTS DE SUPPORTAGE



Supports maintenant tous les composants dans l'enceinte à vide

Résine, composite, Alliage titane, ...

- Rigides et stables dans le temps : Supporter le poids des composants et conserver le bon alignement de la masse froide
- Transitions chaud/froid : limiter les transferts de chaleur par conduction





ENCEINTE A VIDE



Enceinte métallique dans laquelle règne le vide d'isolation pour minimiser les transferts thermiques par convection Acier au carbone, acier inox, aluminium (Tenue en pression, propriété magnétique, cout ...) Structure étanche : garantir 10⁻⁷ bar à Elle doit être munie : l'intérieur de l'enceinte - Supports pour la fixation au sol - Ports pour le coupleur, la distribution cryogénique, l'instrumentation ... Structure rigide : Aucun risque de flambage Points d'attache de la masse froide - Supports pour l'alignement Port d'instrumentation Vanne de sécurité Support Enceinte à vide 'alignement optique Fond Point d'attache de Port **Supports** la cavité coupleur



COMPOSANTS PRINCIPAUX

ENCEINTE A VIDE









G FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





Les cavités SRF sont généralement refroidies avec un bain saturé isotherme (équilibre des phases liquide et gaz): -T = 4.2K et P = 1 bar-T < 2.1K et P < 30 mbar → Pressions stables, limitation des variations de pression qui ont un impact sur la fréquence de la cavité → Pompage sur le bain pour descendre la T < 2.1K

Les aimants sont souvent refroidis avec un liquide sous-refroidi :

→ Les surfaces sont complètement couvertes par le liquide, stabilisation des supraconducteurs



Helium phase diagram





Exemple de P&ID pour le cryomodule ESS :



- Eléments de sécurité (disque de rupture, vannes
- de sécurité pressure),
- Vannes de contrôle
- Circuit de vide
- Diagnostics de fonctionnement, capteurs

Bain d'helium II saturé à 2K dans le tube séparateur de phases

P. 21





□ INTRODUCTION

G FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

□ ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





> Transfert par conduction :

Toute pénétration partant de la température ambiante (coupleur de puissance, instrumentation...)
Supports mécaniques

Transfert par rayonnement :

- Le plus important (varie in T⁴)

> Transfert par convection :

Négligeable si niveau de vide d'isolation
 suffisant à l'intérieur de l'enceinte (< 10⁻³mbar)





Identifier les dissipations thermiques :

- → Impact sur le choix des matériaux et les formes géométriques
- → Bilan des pertes de charge statique (⇔ consommation de fluides cryogéniques).

Pertes de charges dynamiques (fonctionnement de la cavité et du coupleur):

- Fonctionnement pulsé: Pstat. >> Pdynam → atteindre un bonne isolation thermique
- Fonctionnement continu (CW): Pdynam>>Pstat. → résoudre les problèmes d'échauffement



CONDUCTION



Transfert de chaleur par conduction **>** Tous les supports mécaniques

Le flux conductif (W) est donné par la loi de Fourier :

$$\dot{Q} = -\frac{A}{L} \int_{T_1}^{T_2} \lambda(T) dT$$

 $\begin{array}{lll} A & : \mbox{ section } (m^2) \\ L & : \mbox{ longueur } (m) \\ \lambda(T) & : \mbox{ conductivité thermique } (W/mK^{-1}) \end{array}$

Pour limiter le flux Q tout en garantissant la tenue mécanique :

- ≻ Géométrie : ∖A, ≯L
- > Matériau ayant une faible conductivité λ (T)
- > Thermalisation à des températures intermédiaires





CONDUCTION



80K

Exemple : Tirants entre le tank hélium et l'enceinte à vide

Matériau: AISI 304L Diamètre D: 8mm Longueur L: 665mm

> Sans thermalisation :

$$\dot{Q} = -\frac{A}{L}\int_{300}^{4}\lambda(T).dT = \underline{0.23W}$$
 partirant

Avec une thermalisation à T=80K:

$$\dot{Q}_{80} = -\frac{A}{(L-x)} \int_{300}^{80} \lambda(T) dT \qquad \dot{Q}_4 = -\frac{A}{x} \int_{80}^4 \lambda(T) dT$$

X La position optimale x est obtenue en minimisant la puissance nécessaire pour évacuer les flux interceptés à 4K et 80K vers l'ambiante en tenant compte du rendement de Carnot **Cycle idéal Carnot**: $\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{W}} = \frac{T_c}{T_w - T_c}$ Avec \dot{W} : Travail nécessaire que doit fournir l'usine cryo pour dissiper Q à $T_c(T_w=300K)$ 40 35 30 25 20 15 10 Avec une interception at 80K ==> $\dot{W} = \dot{W}_{80} + \dot{W}_{4} = \frac{220}{80} \times \dot{Q}_{80} + \frac{296}{4} \times \dot{Q}_{4}$ $= \dot{W}\left(\frac{x}{L}\right) = \frac{a_1}{1 - \frac{x}{L}} + \frac{a_2}{\frac{x}{L}} \rightarrow \text{Optimum: } x/L = 0.65$ $\dot{Q}_{80} = \underline{0.59W} \quad \dot{Q}_4 = \underline{0.04W}$ Sans interception 0 0 0.2 0.8 0.6 0.4 0.65 x/L \dot{W} =17.2W contre \dot{W} =4.8W

ASPECTS THERMIQUES



CONDUCTION



Exemple: Tirants du CRYOMODULE B SPIRAL2







Tirants latéraux entre la cavité et l'enceinte à vide, thermalisés à 80K

Tresses en cuivre entre les tirants et l'écran thermique







1,8K

P. 27



RAYONNEMENT



Transfert par rayonnement → Toutes les surfaces des composants

Le flux radiatif (W) est donné par la loi de Stefan-Boltzmann :

 $\dot{Q}_{12} = \sigma.F_{12}.S_1.(T_1^4 - T_2^4)$ S₁ : Surface area (m²) F₁₂ : View factor (dependent)

- : Stefan Boltzmann constant (=5.67x10⁻⁸ W/m²K⁻⁴)
- : View factor (depends on geometry and emissivity)

Où \dot{Q}_{12} est la puissance thermique de la surface 1 vers la surface 2.



- \blacktriangleright Matériau avec faible émissivité ε (surfaces brillantes ...)
- Ecran thermique refroidi activement à T° intermédiaire
- Ecran thermique passif MLI (MultiLayer superInsulation)



RAYONNEMENT



Exemple : Flux radiatifs sans et avec écran thermique Enceinte à vide en acier inox : Masse froide (train de cavités) : Diamètre = 0.5 m Diamètre = 0.8 mε = 0.2 ε = 0.1 T° = 2K T° = 293K Pour 1m de longueur : > Sans écran : $Q_{\text{massefroide}} \cong 53W$ $\dot{Q}_{ecran-therm} \cong 68W$ $\dot{Q}_{massefroide} \cong 0.2W$ > Avec un écran en aluminium: Diamètre = 0.7 mε = 0.1 $T^{\circ} = 75K$ > Couches de MLI sur l'écran aluminium : $\dot{Q}_{ecran-therm} \cong 3.3W$ $\dot{Q}_{massefroide} \cong 0.2W$ 30 couches MLI de 293K: 1.5W/m²

ASPECTS THERMIQUES







Exemple : Ecrans thermiques du Cryomodule B – SPIRAL2

MLI placée sur l'écran magnétique de chaque cavité, circuits et soufflets

MLI placée sur l'écran thermique





ASPECTS THERMIQUES





P. 31





Cryomodule B – SPIRAL2

Composants	Charges statiques à 80K [W]	Charges statiques à 4K [W]	
Ecran thermique	46.7	0.42	
Système de supports (tirants)	3.93	2.55	
Transitions chaud/froid	1.67	1.54	
2 coupleurs	10	1.5	
Système d'accord à froid	1.07	0.16	
Instrumentation	0.3	2.30	
Total	64	8.5	

Cryomodule ESS Spoke (en cours d'études)

Composants	Charges statiques à 50K [W]	Charges statiques à 2K [W]	
Ecran thermique	10	0.4	
Système de supports (tirants)	4	0.2	
Transitions chaud/froid	6	0.4	
Equipement de sécurité	4.1	0.25	
2 coupleurs	-	2.	
Vannes de controle	3	1.5	
Instrumentation	8	0.2	
Total	35	5.	

Cryomodule MAX Spoke (en cours d'études)

Composants	Charges statiques à 70K [W]	Charges statiques à 10K [W]	Charges statiques à 2K [W]
Ecran thermique	<30	-	0.2
Space frame	16	1	<0.1
Transitions chaud/froid	4.34	-	0.2
Equipement de sécurité	<2.	-	0.1
2 coupleurs	<35	<7	<2.1
Instrumentation	<5		0.5
Total	<92	<8	<3.2

ASPECTS THERMIQUES

Cryomodule Type TTF

	Charges statiques	Charges statiques	Charges statiques	
	à 40/80K [W]	à 4K [W]	à 2K [W]	
Total	70	13	3.5	





□ INTRODUCTION

GINCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

□ ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE







Champ de température

- Contractions thermiques
- Contraintes thermiques

Vide d'isolation

Pression externe

Gravité

• Poids des composants



Impact sur l'alignement et la stabilité des composants

ASPECTS MECANIQUES





Comment estimer les contractions et contraintes thermiques? Contractions thermiques : T1 Un tirant : T2 ΔL $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T \quad \alpha$: Coefficient de dilatation thermique (1/K or 1/°C) : Longueur caractéristique (m) L ΔT : Différence entre températures finale et initiale (K or °C) > Un tube : $\Delta R = \alpha . R . \Delta T$ **Contraintes thermiques :** Si une force F est appliquée pour rallonger à la longueur initiale:

D'après la loi de Hooke :

$$\sigma = \frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$





Limiter les contraintes thermiques σ selon le type de connexion

$$\sigma = \frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Matériau avec un faible coefficient de

dilatation thermique : $\mathbf{Y}\alpha$

- Ex : Résines, composites, TiA6V
- Matériau avec un faible module d'Young : SE
 - Ex : Résines, composites
- Géométrie : 7 Flexibilité
 - Ex : soufflet compensateur, tube coudé...
- Conditions limites : Relâcher des degrés de liberté
 - Ex : liaison rotule, liaison glissière
- Matériau à haute limite élastiqueRe ou haute limite à la rupture Rm

Dilatations thermiques des différents matériaux $\Delta L/L$:





ASPECTS MECANIQUES





Exemple : Tirant entre le tank hélium et l'enceinte à vide

Profil de température dans le tirant : 1.

$$\dot{Q} = -\frac{A}{x} \int_{\tau_1}^{\tau} \lambda(T) dT = -\frac{A}{L} \int_{\tau_1}^{\tau_2} \lambda(T) dT = Cst$$



Contraction du tirant : 2.

Découpe du tirant en plusieurs sections, chacune définie par une température moyenne :

 $\Delta L = \sum \Delta L_i = \sum \left(L_i^{293} - L_i^T \right)$

Pour L=400mm:	AISI 304L:	∆L = 0.67 mm
	G10:	∆L = 0.47 mm
	TIA6V:	∆L = 0.36 mm

Contraction du tank hélium : 3.

 $\Delta R = \alpha \cdot R \cdot \Delta T$

Contrainte thermique dans le tirant : 4.

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = E \cdot \frac{\Delta L + \Delta R}{L_{_{293}}}$$
 (Tank hélium et enceinte à vide sont supposés infiniment rigide)

Titane:	∆R = 0.19 mr

Pour R=150mm: AISI 304L: ΔR = 0.38 mm

 $\Lambda R = 0.19 \text{ mm}$

Pour un tank hélium en AISI 304L:

Tirant en AISI 304L :	σ = 525 MPa
Tirant en TIA6V:	σ = 200 MPa

ASPECTS MECANIQUES









Température non uniforme de la table durant la mise en froid due à la variation de température du fluide cryo de l'entrée à la sortie du tube de refroidissement.

	ΔT _{max}	δX	δY	δZ	$\sigma_{\text{V.M.}}$
Etat transitoire	70 K (150-80)	3,4 mm	2,7 mm	1 mm	43 MPa
Etat stationnaire	0 (80-80)	3,4 mm	1,6 mm	1 mm	50 MPa



VIDE D'ISOLATION



La pression externe génère sur les parois de l'enceinte à vide :

Chaque pays applique sa norme de construction pour les appareils à pression : _____ Exigences de design, de matériaux, de fabrication, de tests de contrôle. Ex : CODAP (France), Norme européenne EN 13445, ASME (Etats Unis).

Dans le CODAP :

• Classification des appareils à pression en fonction de leur volume, de la pression maximum admissible et de la nature du fluide.

• Une enceinte à vide ne rentre pas dans une catégorie à risque mais le design et la fabrication suivent les règles.

Ces exigences sont applicables pour le design de : l'enceinte à vide, des brides et des soufflets.

Déterminer la pression critique de flambage :

Pour des formes simples :

- Utilisation de normes (CODAP, Norme européenne) avec un coefficient de sécurité (prise en compte des défauts fabrication : géométrie, matériaux)
- Formules analytiques (Roark) sans coefficient de sécurité

Pour des formes plus complexes :

• Analyse par éléments finis





VIDE D'ISOLATION



Exemple : Enceinte à vide cylindrique non renforcée

Matériau : Acier P235GH NF EN 10028-2 Diamètre externe De: 800mm Longueur L: 6500mm Epaisseur : 10mm



> CODAP: Calcul de la pression maximale admissible

 $Pa = \frac{4}{3} \frac{B}{De/e} \cdot K$ K=1 : pour fonctionnement normal K=1.35 : pour fonctionnement exceptionnel

- A partir d'un abaque, déterminer le coefficient A = f($\frac{L}{D_e}$, $\frac{D_e}{e}$) \Rightarrow A = 0.0002

- A partir d'un abaque, déterminer le coefficient B = f(A, matériau, T°) $\rightarrow B = 20 (MPa)$

Pa = 0,33 *MPa*

Formule de Roark : Calcul de la pression critique de flambage

$$Pcrit = 0,807 \cdot \frac{E \cdot e^2}{L \cdot R} \cdot 4 \sqrt{\left(\frac{1}{1 - v^2}\right) \cdot \frac{e^2}{R^2}}$$

(Formule valable pour un tube court)

 $P_{crit} = 1,04 MPa$



Facteur de sécurité ~ 3: P_{crit} (Roark) = 3,15 x Pa (CODAP)





VIDE D'ISOLATION







GINCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

□ ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





ISOLATION MAGNETIQUE CONTRE LE CHAMP TERRESTRE

Limiter l'effet du champ magnétique sur les dissipations thermiques

Rappel : Le champ magnétique terrestre augmente la résistance résiduelle du niobium se traduisant par une augmentation des dissipations thermiques (pertes RF).

$$P_{RF} = \frac{1}{2} \iint R_S . H_S^2 . dS$$

Avec R_s : résistance de surface du matériau H_s : champ magnétique à la surface du matériau

Lors de la mise en froid des cavités, les lignes de champ magnétique sont piégés dans le niobium.

Objectif : Atténuer le plus possible le champ magnétique B (typiquement B_{max} entre 10 et 20 mG).

Remarque : Selon la localisation sur la terre, le champ magnétique terrestre varie de 30µT [300mG] à 60µT [600 mG]





Exemple : Ecran magnétique de la cavité spoke ESS

- Calcul du facteur d'écrantage S (=B_{ext}/B_{int})
 - Epaisseur de l'écran pour atteindre B_{int} <10 mG</p>

Cas d'un écran cylindrique horizontal soumis :



$$S_{\perp} \cong \frac{\mu d}{D} + 1$$

A un champ horizontal :

$$S_{II} \cong 4NS_{\perp} \text{ où } N \approx \frac{D^2}{2L^2}$$

- S₁ S₁ Ecran
- μ : perméabilité de l'écran (15000 mini)
- d : épaisseur de l'écran (2x1mm)
- D : diamètre de l'écran (570mm)
- L : longueur de l'écran

Application numérique :

 $S_{\perp} \cong 53$ pour un champ vertical Bext = 50 μT , Bint = 0.93 μT (9.3mG) < 10 mG

Impact des ouvertures Analyse FEM



P.44





GINCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

□ DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





Supports des composants à l'intérieur de l'enceinte à vide (cavités, écrans ...)

Quel que soit le type de support, les fonctions exigées sont :





Le design mécanique des supports dépend de 2 contradictions techniques



DIFFERENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE





→ Il n'y a pas de solution unique ...





Enceinte à vide

 ΔL identique

Masse froide

Utilisation de tirants antagonistes

- Préservation de l'alignement dans le plan formé par les tirants : Les tirants ont la même contraction thermique
- Limitation des contraintes thermiques : le tirant ne subit pas la contraction thermique de la masse froide
 Supports plus longs : Limiter la conduction

> Joindre les tirants à l'enceinte à vide

Possibilité d'ajuster l'alignement après mise en froid

Exemple : Cryomodule B - SPIRAL2

Tirants antagonistes en horizontal

Pour ajuster l'alignement latéral
Pour maintenir l'alignement latéral de la cavité

Tirants verticaux

o Pour supporter le poids
o Déplacement vertical de la cavité pour anticiper l'alignement



SUPPORTAGE

Ы

DIFFERENTS CONCEPTS

SUPPORTS D'APPUI













CADRE SUPPORT (SPACE FRAME)



Utilisation d'un cadre support

• Le train de cavités est aligné sur son spaceframe en dehors de l'enceinte à vide

> Utilisation de tirants antagonistes

Préserver l'alignement des cavités après la mise en froid



Exemple : ESS Cryomodule pour cavités elliptiques (solution type SNS)







- > Utilisation du tube double paroi du coupleur de puissance comme support
- Assure l'alignement de chaque cavité le long de l'axe faisceau (point fixe)

> Utilisation de supports inter-cavité

- Glissement relatif entre cavités adjacentes le long de l'axe faisceau
- Apporter un second support vertical (éliminer le porte à faux)







G FONCTIONS D'UN CRYOMODULE

COMPOSANTS PRINCIPAUX

□ SCHEMA CRYOGÉNIQUE D'UN CRYOMODULE

ASPECTS THERMIQUES

ASPECTS MECANIQUES

ASPECT MAGNETIQUES

DIFFÉRENTS CONCEPTS DE SUPPORTAGE

PROCESS D'ASSEMBLAGE





En salle blanche

• Assemblage du train de cavités et coupleurs avec un pré-alignement

- En dehors de la salle blanche : Insertion de tous les composants de l'enceinte à vide
 Assemblage des autres équipements du train de cavités : Système d'accord à froid, écran magnétique, instrumentation,...
 - Assemblage des écrans thermiques, lignes de distribution cryo,...
 - Insertion à l'intérieur de l'enceinte,
 - Procédure d'alignement

Pour chaque étape, il est nécessaire de fournir :

- Des outillages spécifiques
- Des infrastructures adéquates



PROCESS D'ASSEMBLAGE



En salle blanche :

Assemblage de la cavité avec :

- le coupleur de puissance
- le système d'accord à froid (SAF ou CTS)



Outillage de salle blanche

Coupleur

Insertion et connexion des cavités dans la partie intermédiaire de l'enceinte à vide :



Une partie de l'enceinte à vide Charriot de transport



PROCESS D'ASSEMBLAGE DU CRYOMODULE B – SPIRAL2



En dehors de la salle blanche :













Objectif:

Aligner les tubes faisceau de toutes les cavités le long de l'axe faisceau.

Les tubes faisceau ne sont plus accessibles une fois le cryomodule fermé → Report de l'axe des tubes faisceau : références externes (nouveaux repères)

Aligner les cavités à l'intérieur du cryomodule Aligner les cryomodules les uns par rapport aux autres

Equipements de mesures:



Théodolite





Retro-réflecteur



Sphère Taylor Hobson





Reports de l'axe faisceau sur le tank hélium :



Les défauts de tolérance maximum de l'alignement global sont : - ± 1 mm en translation pour les cryomodules

 $-\pm 0.3^{\circ}$ en rotation (X,Y) pour les cryomodules









Le design mécanique d'un cryomodule dépend d'une variété de paramètres qui nécessitent des connaissances en :

Mécanique, thermique, vide et cryogénie.

Au laboratoire IPNO, le design mécanique d'un cryomodule est effectué par le bureau d'études avec l'aide d'autres collègues de la division Accélérateurs (total : 90 personnes) :

- Des experts en cryogénie et vide
- Des experts sur les cavités RF
- Des experts en dynamique faisceau





- H. Saugnac, IPN Orsay, "Cryostat : construction et mise en oeuvre", Journées cryogéniques d'Aussois, 2003
- Paolo Pierini, INFN-Milan, "overview of cryomodules for proton accelerators", ESS Bilbao initiative workshop, 2009
- N. Ohuchi, KEK, "Fundamentals of cryomodule", SRF 2009 tutorial program, 2009
- T. H. Nicol, Fermilab, "Fundamentals of Cryomodule Design: Theory and Practice, Part II Mechanical Considerations", SRF 2011 tutorials
- V. Parma, CERN, "Cryostat design II: Application to cryostat design", Cryostat Design Seminar at GSI, 2005
- H. Saugnac, IPN Orsay, "Design review of the SPIRAL2 cryomodule B", 2008
- P. Duthil, S. Rousselot & P. Duchesne, IPN Orsay, "SPL Cryomodule Conceptual Design Review Vacuum Vessel and Assembly Tooling", 2011
- D. Reynet, P. Duthil & S. Bousson, IPN Orsay, "Engineering Design of the ESS Spoke Cryomodule", SLHIPP meeting, 2013
- G. Olivier & J.P. Thermeau, IPN Orsay, "ESS Cryomodule for elliptical cavities (Medium and high beta)", SLHIPP meeting, 2013





MERCI POUR VOTRE ATTENTION